



KCS 2027 전시업체 기업소개서

 GANA 본딩 솔루션 전문 기업	대 표 자	유 태규
	홈페이지	https://ganatr.co.kr/
	이 메 일	aaron
	전화번호	031-398-5110
	주 소	경기도 안양시 동안구 별말로123 스마트 베이 A동 805호
	주요물품	정밀 다이본더, 리웍장비, 나노패턴 프린터, 진공리플로우오븐, 접착제 등
회사소개		
주식회사 가나는 첨단 본딩 솔루션 전문기업으로 다양한 고 기능성 접착제 및 경화 장비와 정밀 Die bonder, Flipchip bonder, Wire bonder 첨단 장비 등 One Bonding Solution 을 공급하는 회사입니다. 당사는 20 년 이상의 풍부한 필드 경험 및 다양한 Application 경험을 토대로 최적의 본딩 솔루션을 제안하고, 제품 성능, 공정, 수율 개선에 기여하고 있습니다. 휴대폰, 광통신, 디스플레이, 자율주행, 배터리 및 전장분야 등, 다양한 본딩 작업에 대한 솔루션으로 21 세기 시장 트렌드 변화 및 수요를 미리 예측하고 공급하는 본딩 전문 기업입니다. 초정밀 본딩 솔루션(Chip, solder, 소자 열압착, 레이저, 초음파 본딩) ✓ 플립칩본딩 - 초정밀 fine pitch 열압착, 초음파 본딩. ✓ 정밀 리웍 시스템- 기판 납 제거 및 칩, 소자의 리웍. ✓ 초음파 와이어 본딩: IC 소자 및 배터리셀 전극 연결. ✓ 정밀 레이저 본딩 - 칩, 다이, 구조물을 레이저를 이용한 정밀 본딩. ✓ 마이크로 솔더볼 레이저 셋팅 - 플립칩 범프 형성 및 단자간 정밀 솔더링 연결 특수 소재 본딩 솔루션(Adhesive, Silicon, flux) ✓ 마이크로 전자분야(디스플레이, 멤스, 미세홀 연결) ✓ 자외선 경화기 및 토출 시스템 나노 패턴 프린팅 ✓ 전자 잉크를 사용한 다이렉트 나노 패턴 프린팅 장비 ✓ 최소 300 나노미터 크기의 점 또는 선 프린팅 ✓ 회로 리페어 또는 연구 목적의 회로 형성 진공 리플로우 오븐 ✓ 전자 잉크를 사용한 다이렉트 나노 패턴 프린팅 장비 ✓ 최소 300 나노미터 크기의 점 또는 선 프린팅		